

Obsah

Předmluva	9
I. Vznik plošných spojů	11
II. Základní metody výroby plošných spojů	16
1. Obecný přehled o světovém stavu z hlediska metod	16
2. Základní pojmy	17
3. Vodivé barvy a laky	18
4. Vypalovací laky a pasty	20
5. Přímé nanášení kovů	21
5.1 Nanášení roztavených kovů stříkáním	21
5.2 Přímé nanášení kovů vakuovým způsobem	23
6. Chemické nanášení kovů	27
7. Galvanické nanášení kovů	28
8. Nepřímý způsob výroby spojů	31
9. Způsob zhotovování plošných spojů chemickým odleptáváním	32
10. Metoda ražení pro plošné spoje	34
11. Metoda zalisování vodivého prášku do plastických hmot	37
12. Bezředitlové a xerografické nanášení spojů	37
13. Ohebné a několikavrstvové zalisované spoje	42
14. Trojrozměrný tisk plošných spojů	42
III. Metody praktické výroby plošných spojů	47
15. Vhodnost plátování izolačního laminátu měděnou fólií	47
16. Vytvoření spojů na plátovaný laminát	48
17. Předloha a negativ pro zhotovení šablony	49
17.1 Jednoduchá předloha pro funkční vzorky	49
17.2 Předloha pro konečné provedení a pro sériovou výrobu	50
17.3 Negativ pro zhotovení šablony	51
18. Fototechnický způsob vytváření spojů	56
18.1 Úprava plátovaných destiček	56
18.2 Nanesení citlivé vrstvy na destičku	56
19. Síťotiskový způsob vytváření obrazu spojů	65
19.1 Zhotovení síťotiskové šablony pro plošné spoje	72
19.11 Přenosový způsob	74
19.12 Přímý způsob zhotovení síťotiskové šablony	78
19.2 Technika tisku ochranné barvy	80

19.3	Ofsetový nátisk obrazu spojů	81
19.4	Odleptávání nepotřebných částí fólie	83
19.41	Laboratorní způsoby leptání spojů	86
19.42	Leptací zařízení pro výrobu	88
19.43	Závěrečné operace po leptacím cyklu	90
19.44	Kontrola leptacího roztoku	91
19.45	Regenerace leptacího roztoku	92
19.5	Úprava plošných spojů před pájením	94
19.6	Uspořádání výrobní linky	95
19.7	Použití plošných spojů	98
19.8	Speciální použití plošných spojů	103
19.9	Kapacity vodičů plošných spojů	109
19.10	Plošné indukční cívky	112
IV. Materiály pro plošné spoje		114
20.	Základní materiály	114
20.1	Měděná fólie	115
20.2	Lepidla a tmely	115
20.3	Základní izolant — přehled druhů	115
21.	Výroba měděné fólie	119
21.1	Přerušovaný způsob výroby fólie	123
21.2	Plynulý způsob výroby fólie	123
21.3	Okysličování a nanášení lepidla	127
22.	Spojování měděné fólie s nosným izolantem	128
23.	Základní tuzemské izolační materiály	129
23.1	Výroba sklotextitového laminátu	129
23.2	Epoxydové pryskyřice pro plošné spoje	131
23.3	Cuprextit a Cuprexcart, materiály pro výrobu plošných spojů	134
23.4	Další směry ve vývoji materiálů pro plošné spoje	135
24.	Zkoušky materiálů	135
24.1	Zkušební metody	137
24.2	Zkušební destičky	142
24.3	Závěr o zkoušení	147
V. Obrábění základních materiálů		149
25.	Obecné zásady obrábění plátovaných laminátů	149
26.	Povrchové úpravy plošných spojů	157
27.	Galvanické zúšlechťení kontaktů plošných spojů	161
VI. Součástky pro plošné spoje		164
28.	Hlediska pro výběr součástek	164
29.	Klasické součástky	165
30.	Konstrukční součástky	171
31.	Další vývoj součástek	176
VII. Plošné obvody a miniaturizace		178
32.	Obvody na keramice	179
33.	Plošné obvody RC	182

34. Funkční obvody — moduly	187
35. Další perspektivy	194
VIII. Zásady konstrukce přístrojů s plošnými spoji	198
36. Návrh zapojení přístroje	198
36.1 Předběžný návrh	198
36.2 Návrh skutečného obrazu spojů	199
37. Zvláštnosti konstrukce	200
37.1 Volba velikosti desky	201
37.2 Druhy spojů — výhody a nevýhody	201
37.3 Zatížitelnost plošných spojů	202
37.4 Rozměry a vzdálenosti	203
37.5 Uzemnění — rozdělení ploch — nápisy a označení	205
37.6 Konstrukční uspořádání přístrojů	205
38. Rychlý způsob zhotovení předlohy pro funkční vzorky	206
38.1 Papiřový negativ	206
38.2 Papiřový pomocný pozitiv a retušovaný negativ	207
38.3 Sestavovací předlohy	208
38.4 Opravy negativů	209
39. Zhotovení funkčních vzorků	209
40. Zkoušky s funkčními vzorky	212
40.1 Zkouška oteplení destiček se spoji	212
40.2 Vliv prachu a znečištění na plošné spoje	214
40.3 Zkoušky doby života	214
41. Příprava pro ověřovací sériei	214
42. Příklad tranzistorového přijímače s plošnými spoji	215
42.1 Schéma zapojení	216
42.2 Postup zhotovení destičky se spoji	219
42.3 Montáž součástek	220
42.4 Rozmístění součástek	221
IX. Montáž přístrojů s plošnými spoji	222
43. Použití a výběr součástek	223
44. Způsoby a volba montáže	225
44.1 Ruční montáž	226
44.2 Mechanizovaná montáž	228
44.3 Automatizovaná montáž	231
44.4 Příklady automatizované montáže	235
45. Spojování desek s plošnými spoji	239
46. Technika pájení	243
46.1 Pájka	243
46.2 Tavidlo	246
46.3 Způsoby pájení	247
47. Přehled některých pájecích zařízení	250
48. Zkoušky pájených spojů	253
49. Povrchová ochrana plošných spojů	255
X. Opravy přístrojů s plošnými spoji	261
XI. Ekonomické problémy techniky plošných spojů a obvodů	268

XII. Příloha	273
Literatura	287
Rejstřík	290

291	
292	
293	
294	
295	
296	
297	
298	
299	
300	
301	
302	
303	
304	
305	
306	
307	
308	
309	
310	
311	
312	
313	
314	
315	
316	
317	
318	
319	
320	
321	
322	
323	
324	
325	
326	
327	
328	
329	
330	
331	
332	
333	
334	
335	
336	
337	
338	
339	
340	
341	
342	
343	
344	
345	
346	
347	
348	
349	
350	
351	
352	
353	
354	
355	
356	
357	
358	
359	
360	
361	
362	
363	
364	
365	
366	
367	
368	
369	
370	
371	
372	
373	
374	
375	
376	
377	
378	
379	
380	
381	
382	
383	
384	
385	
386	
387	
388	
389	
390	
391	
392	
393	
394	
395	
396	
397	
398	
399	
400	